



NXP, 갤럭시 Z 플립 3에 프론트 엔드 모듈 공급해 프리미엄 와이파이 6 성능 지원

- NXP 프론트 엔드 모듈 통해 배터리 수명에 영향 최소화하며 삼성 갤럭시 Z 플립 3에 빠르고 안정적인 와이파이 6 성능 지원

2021년 12월 16일, 서울 – NXP 반도체는 자사의 WLAN8101H 및 WLAN8201C 프론트 엔드 모듈(front end module, FEM)을 통해 삼성 갤럭시 Z 플립3에서 와이파이(Wi-Fi) 6 연결을 지원한다고 발표했다.

FEM은 출력 전력, 선형성, 효율성의 탁월한 조합을 제공해 배터리 수명에 미치는 영향을 최소화하면서 빠르고 안정적인 와이파이 연결을 가능하게 한다.

와이파이 최신 세대(802.11ax 또는 와이파이 6)는 디바이스 수 무제한, 대기 시간 감소, 네트워크 용량 및 효율성 증가를 포함해 많은 성능 향상을 제공한다. NXP의 와이파이 6 FEM은 이러한 새로운 표준이 잠재력을 최대한 발휘하는 데 필요한 RF 성능을 제공한다. 이를 통해 삼성 갤럭시 Z 플립 3는 소비자들에게 빠르고 안정적인 와이파이 성능을 제공할 수 있다.

NXP의 WLAN8101H 및 WLAN8201C 디바이스는 QUBiC SiGe WLAN 포트폴리오의 일부로서 출력 전력, 선형성 및 효율성의 최적화된 조합을 제공한다. 이를 통해 가장 까다로운 와이파이 6 변조 형식에서도 전송 범위가 확장되고 수신 감도가 향상돼, 속도와 적용 범위 면에서 전반적인 사용자 경험이 향상된다. 또한 WLAN8101H는 블루투스 성능 향상에도 도움이 된다.

도에코 테르프스트라(Doeco Terpstra) NXP 스마트 안테나 솔루션 부사장 겸 총괄 책임자는 “커넥티드 디바이스의 수가 증가함에 따라, 와이파이 6의 필요성도 증가한다. 와이파이 6는 더 많은 디바이스와 더 많은 데이터에 대한 요구를 해결해 준다. NXP의 FEM은 빠르고 안정적인 연결을 지원해 소비자들이 와이파이 6의 이점을 활용할 수 있도록 지원한다”고 말했다.

더 많은 정보는 [nxp.com/RF](https://www.nxp.com/RF)에서 확인할 수 있다.

NXP 반도체 소개

NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 29,000명의 직원을 고용하고 있다. 2020년 매출은 미화 86억 1천만 불이다. NXP 관련 뉴스는 www.nxp.com에서 찾아볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그(<http://blog.naver.com/nxpkor>)에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.